

Informations de base	
2013/2905(DEA)	Procédure terminée - acte délégué entre en vigueur
DEA - Procédure d'acte délégué	
Exemption pour le plomb dans les soudures sur les cartes de circuits imprimés, les revêtements des extrémités des composants électriques et électroniques et les revêtements des cartes de circuits imprimés, les soudures de raccordement des fils et des câbles et les soudures de raccordement des transducteurs et des capteurs qui sont utilisés durablement à une température inférieure à – 20 °C	
Complétant 2008/0240(COD)	
Subject	
3.40.06 Industries électronique, électrotechnique, TIC, robotique	
3.70.13 Substances dangereuses, déchets toxiques et radioactifs (stockage, transport)	

Acteurs principaux			
	Commission au fond	Rapporteur(e)	Date de nomination
Parlement européen	Commission au fond ENVI Environnement, santé publique et sécurité alimentaire		